

Low-k epoxy reactive diluent

低誘電率エポキシ反応性希釈剤

FOLDI

■ 特長 Characteristics

低誘電特性

Low-k material

● 多分岐構造由来

Derived from multibranching structure

低揮発性

Low volatility

物性改質

Physical property modifier

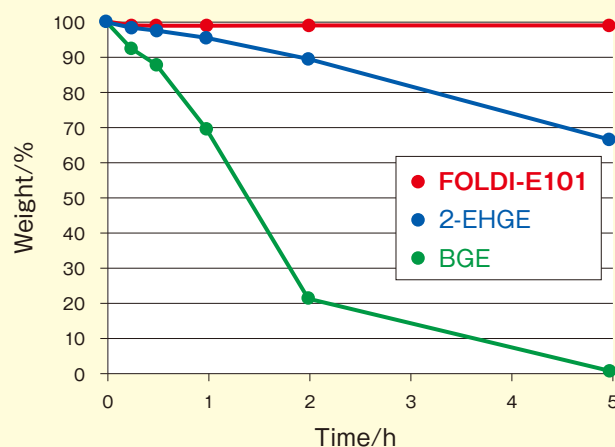
● 低吸水性

Low water absorption

● 接着力改善

Improvement of adhesion

■ 150°C揮発性 Volatility at 150°C



2-EHGE: 2-エチルヘキシルグリシジルエーテル
2-Ethylhexyl glycidyl ether

BGE: ブチルグリシジルエーテル
Butyl glycidyl ether

■ 物性 Monomer property

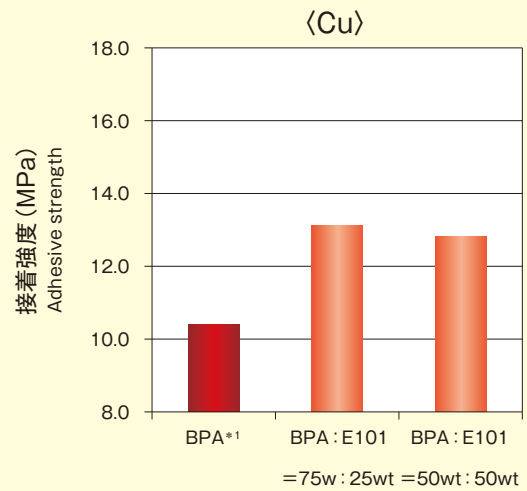
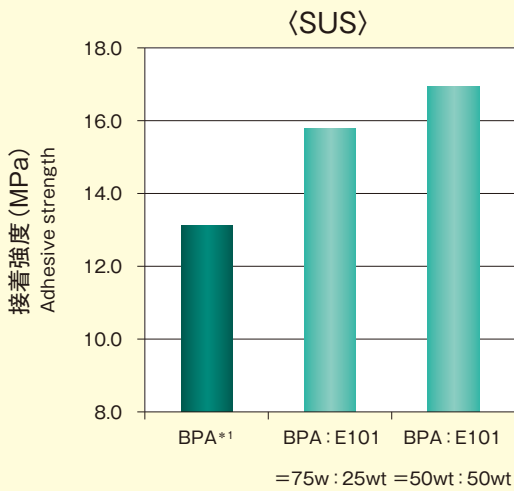
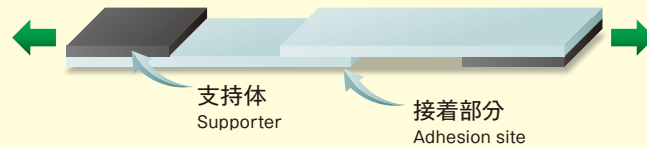
Item	Unit	E101
性状 Appearance	—	Pale yellow, clear
エポキシ当量 EEW	g/eq	330-350
粘度 Viscosity (25°C)	mPa·s	40
良溶媒 Good solvent (Soluble, 50 wt.% or more)		IPA, Hexane, Toluene, NMP, MIBK, PGME, PGMEA

※FOLDI-E101は残留塩素の制御が可能です。



日産化学株式会社

■ 接着力改善効果 Improvement of adhesion



*1: jER828 (三菱化学株式会社)

*1: jER828 (Mitsubishi Chemical Corporation)

■ 物性改質効果 Modification effect of physical property

Item		unit	Alicyclic epoxy*1		TEPIC®	
Blend ratio	TEPIC®	wt%	100	50	100	50
	FOLDI-E101	wt%	—	50	—	50
曲げ弾性率 Flexural Modulus		MPa	3,400	2,900	3,900	3,000
曲げ撓み Flexural Length		mm	8	10	9	12
煮沸吸水率 Water Absorption (100 °C for 100 h)		wt%	3.55	1.06	4.51	1.15
Tg (DMA)		°C	239	144	245	191
比誘電率 Dielectric constant (Dk) @1MHz		—	3.34	2.94	3.53	2.98
誘電正接 Dielectric loss tangent (Df) @1MHz		—	0.014	0.006	0.017	0.007

*1: セロキサイド 2021P (株式会社ダイセル)

*1: CELLOXIDE 2021P (Daicel Corporation)

(硬化条件)

硬化剤: リカシッド MH-700 (新日本理化学株式会社)
 硬化促進剤: ヒシコーリン PX-4ET (日本化学工業株式会社)
 硬化プロセス: 100°C/2h → 150°C/5h

(Curing condition)

Hardener: RIKACID MH-700 (New Japan Chemical Co.,LTD.)
 Accelerator: HISHIKOLIN PX-4ET (Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd.)
 Curing condition: 100°C/2h → 150°C/5h



日産化学株式会社

〒103-6119 東京都中央区日本橋2-5-1
 日本橋高島屋三井ビルディング

化学品事業部 ファインケミカル営業部

TEL: 03-4463-8151 FAX: 03-4463-8138
 URL: <http://www.nissanchem.co.jp>